

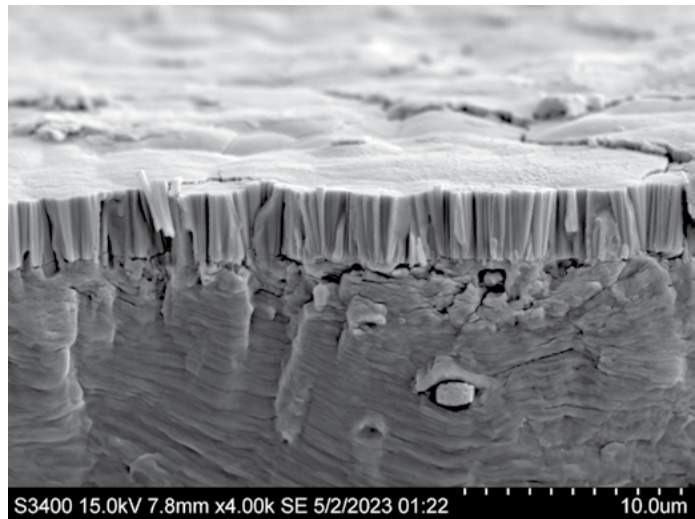
# Affinity Flex

面向 ENIG 和 ENEPIG 应用

## 优异的化学镀镍为柔性电路应用释放应力

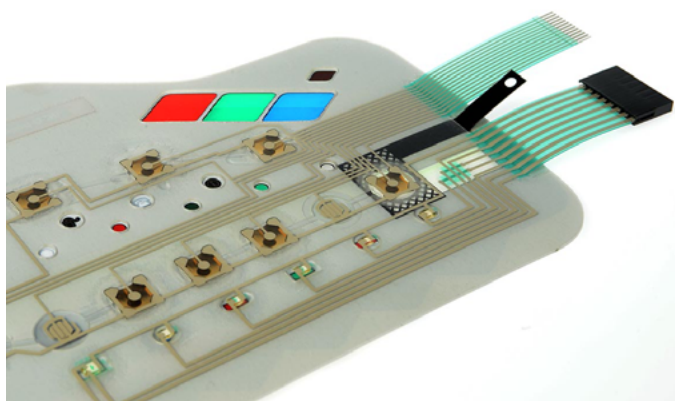
**Affinity Flex** 是麦德美爱法最新的化学镀镍技术, 专为 ENIG 和 ENEPIG 柔性电路制造而设计。传统的化学镀镍 (EN) 系统使柔性电路在弯曲时容易出现大的裂纹扩展和断路风险。Affinity Flex 化学镀镍系统的独特柱状晶粒结构可通过多个较小的微裂纹诱导应力释放, 防止裂纹扩展至铜。

Affinity Flex 在非常长的化学镀镍工作寿命期间保持高可靠性和高性能, 并无需预镀, 不仅减少了钯消耗, 而且在提供高可靠性的同时还降低了运营成本。



## 主要特性优点

- 适用于 ENIG 和 ENEPIG 应用
- 兼容无氰镀金技术
- 化学镀镍断裂机理可防止裂纹向下层铜传播
- 性能稳定, 长达 6 个 MTO
- 符合 IPC 4556A 和 4552B 标准
- 降低废物处理成本
- 减少化学品消耗
- 减少贵金属消耗
- 降低二氧化碳排放量



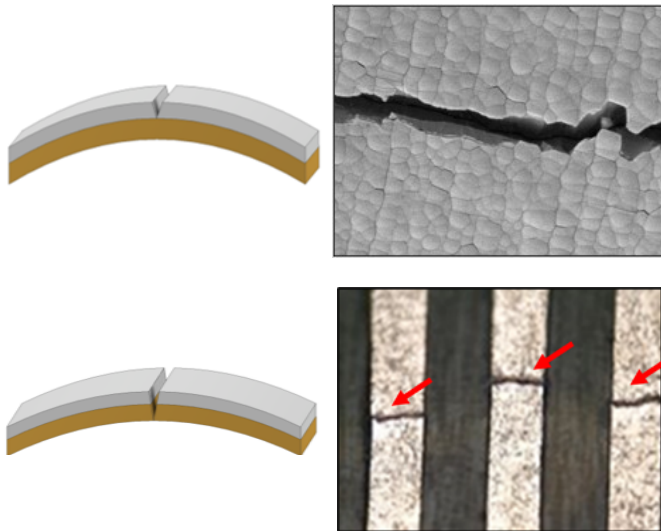
# Affinity Flex

面向 ENIG 和 ENEPIG 应用

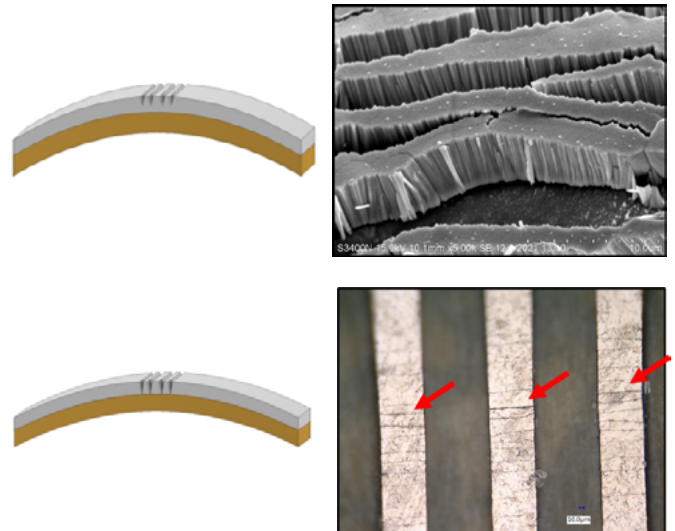
## 无可匹敌的独特晶粒结构

在标准 ENIG 的弯曲过程中, 通过单个大裂纹进行应力释放, 这样的裂纹会延伸至下层铜。Affinity Flex 的柱状晶粒结构可通过多个较小的裂纹诱导应力释放, 防止裂纹扩展至下层铜。

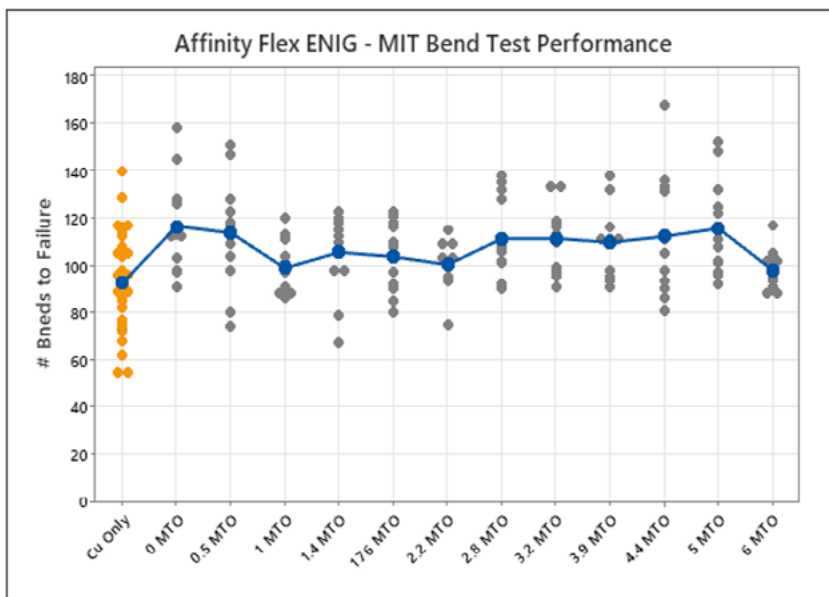
标准ENIG



柔性 ENIG



## 优异的可靠性



- Affinity Flex ENIG 的弯曲试验结果与裸铜基板相当
- 弯曲试验性能稳定, 可长达 6 个 MTO

